

「半導体アプリケーションチッププロジェクト
(情報家電用半導体アプリケーションチップ技術開発)」評価委員会
(平成 19 年度までに終了した個別テーマの事後評価)

委員名簿 (案)

氏名	所属及び役職
委員長 浅田 邦博 <small>あさだ くにひろ</small>	東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター センター長・教授
委員 中島 康彦 <small>なかしま やすひこ</small>	奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
委員 永田 隆一 <small>ながた りゅういち</small>	アンカー・ビジネス・システムズ株式会社 代表取締役社長
委員 前口 賢二 <small>まえぐち けんじ</small>	半導体産業研究所 所長
委員 向林 隆 <small>むかいばやし たかし</small>	株式会社アイティーファーム ジェネラルパートナー

(敬称略、五十音順)